



Fully Automatic Epoxy Die Bonder
DBX-1000

New

实现高精度·高产能且操作舒适
采用最新技术的LED固晶机

High speed, High accuracy
and User-friendly operation
LED Die Bonder



DBX-1000 特点

- 高速度·高精度的固晶机
- 数字可程式的点胶以及固晶焊头
- 数字化粘合力

Features of DBX-1000

- High speed & accuracy Epoxy Die Bonder
- Epoxy, Bonding head digital programmable
- Digitalized bonding force

DBX-1000

Fully Automatic Epoxy Die Bonder

主要规格

固晶方式	环氧树脂点胶
固晶速度	0.18秒/循环 (不含工艺制程时间)
固晶重复精度	位置: $\pm 25 \mu\text{m}$ (3σ) 角度: $\pm 3^\circ$ (3σ)
固晶范围	X : 220mm Y : 92mm
固晶压力	30~180g
芯片尺寸	$\square 0.15 \sim \square 1.5\text{mm}$
支架尺寸	长 : 90~230mm 宽 : 20~100mm 厚 : 0.1~2mm
料盒尺寸	长 : 95~235mm 宽 : 30~110mm 高 : 100~175mm 存放数量 : 2~3个料盒
晶圆尺寸	4英寸用扩晶环 (外形 $\phi 152\text{mm}$) 6英寸用扩晶环 (外形 $\phi 210\text{mm}$) /OP
操作系统	Windows 7 Embedded
气压	0.4Mpa (4Kgf/cm ²) 以上 (消耗量 : 30l/min)
供电电源	单相 AC200~240V 50/60Hz
功率	0.9KVA
外形尺寸	W1750 × D1080 × H2050mm (不包含警告灯)
重量	930kg

SPECIFICATIONS

Bonding System	Epoxy resin
Bonding Speed	0.18sec/cycle (Dry run)
Repeatability of Bonding Accuracy	Position: $\pm 25 \mu\text{m}$ (3σ) Angle: $\pm 3^\circ$ (3σ)
Bonding Area	X : 220mm Y : 92mm
Bonding Force	30~180g
Chip Size	$\square 0.15 \sim \square 1.5\text{mm}$
Lead Frame Size	Length : 90~230mm Width : 20~100mm Thickness : 0.1~2mm
Magazine Size	Length : 95~235mm Width : 30~110mm Height : 100~175mm No. of Stock : 2~3 Magazines
Wafer Size	Grip ring for 4 inch wafer (Outer $\phi 152\text{mm}$) Grip ring for 6 inch wafer (Outer $\phi 210\text{mm}$)/OP
Operation System	Windows 7 Embedded
Air	0.4Mpa (4Kgf/cm ²) or more (Consumption : 30l/min)
Power Source	AC200~240V 50/60Hz
Power Consumption	0.9KVA
Overall Dimensions	W1750 × D1080 × H2050mm (Including indicating lamp)
Weight	930kg

- ⚠ 安全注意事项:** 为了安全使用产品, 使用前请仔细阅读操作说明书。
● 目录上的注意点... 目录上所刊载商品的规格以及外观如有所改良恕不另行通知, 请知悉。

- ⚠ CAUTION FOR SAFE:** Please read surely INSTRUCTION MANUAL before operate.
● Specification is subject to change without prior notice for improvement.

 KAIJO CORPORATION URL: <http://www.kaijo.co.jp>

日本总公司: 焊线事业部

東京都羽村市栄町3-1-5 〒205-8607 TEL 81-42-555-6162 FAX 81-42-579-5175

上海楷捷半导体科技有限公司

KAIJO SEMICONDUCTOR TECHNOLOGY(SHANGHAI)CO.,LTD.

上海市闵行区莲花路1733号D栋109室

TEL 021-62751515 FAX 021-32160677

URL: <http://www.kaijo.cn>